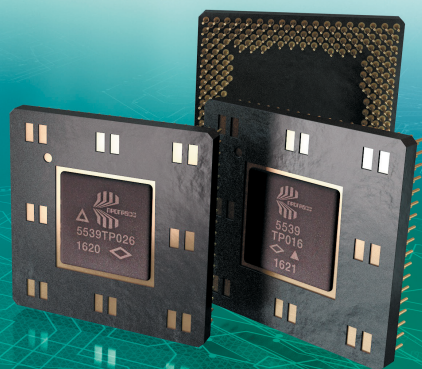


## 5539TP026 и 5539TP016

Полузаказные СБИС со встроенными микропроцессорными ядрами



Разработка прошивки производится по ГОСТ 2739 4-87 с выпуском карты заказа установленной формы

	БК 5539TP016	БК 5539TP026
Технические условия	АЕНВ.431260.274ТУ	АЕНВ.431260.275ТУ
Децимальный номер КД	ИЛТА.431268.022	ИЛТА.431268.021
Категория качества	ВП	
Исполнение	корпусное/бескорпусное	

### Области применения

- комплексные системы управления полётом пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов;
- аппаратура связи, радиолокации, опознавания;
- ответственные системы управления энергогенерирующими и энергопотребляющими объектами;
- системы управления функционированием и движением наземных и воздушных объектов.

### Назначение микросхемы

Базовые кристаллы 5539TP026 и 5539TP016 являются дальнейшим развитием БК К5512БП1Ф. Полузаказные программируемые СБИС центрального вычислителя (5539TP026) и периферийного вычислителя (5539TP016) предназначены для создания на их основе нового поколения комплексных систем управления полётом (КСУП) пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов с применением разнородных каналов связи. СБИС обеспечивают проектирование на их основе схем требуемого функционального назначения со специализированным программным обеспечением, реализуемым

микропроцессорными ядрами и аппаратной реализацией специальных функций на «зашивках» БМК. В результате заказчик получает специализированную программно-аппаратную «систему в кристалле».

**5539TP026 и 5539TP016 — лицензионно чистые продукты, изготавливаются на отечественной технологической линейке ОАО «НИИМЭ и Микрон».**

### Состав микросхемы

- Микропроцессорное ядро — 32-разрядный RISC микроконтроллер KVARC с тактовой частотой до 150 МГц.
- Внутренняя память ОЗУ — 32Кх32/64Кх32 для поддержки работы микропроцессора.

- ПЗУ — 128Кх32 — для хранения программ.
- Набор интерфейсов и шин — SPI, I2C, GPIO.
- Количество программируемых вентилях — 800 тыс./1500 тыс., со встроенным ОЗУ — 2х8Кх16.

### Параметры тестовых «зашивок»

	БК 5539TP016	БК 5539TP026
Технология изготовления (отечественная фабрика)	КМОП 0,18 мкм	
Корпус металлокерамический	CPGA-325	
Напряжение питания ядра, В	1,8 ±10%	
Объем ОЗУ, Мбит	1	2
Высокоскоростные приемо-передатчики	6	12
Интерфейс ГОСТ Р 52070 (MIL-STD 1553 B)	+	
Интерфейс ГОСТ 18977 (ARINC-429)	+	
Потребляемая мощность, в динамическом режиме, Вт	3	5
Напряжение питания периферийных блоков, В	3,3±10%	
Температурный диапазон, °С	-60...+100	

По вопросам приобретения: